

# NEWSLETTER

## VERMES Microdispensing发布新一代高标准 “性能王” MDS 1560热熔胶方案

VERMES Microdispensing微密斯点胶科技在世界顶级的电子制造贸易展——慕尼黑电子生产设备博览会上发布最新MDS 1560热熔胶系统，进一步巩固市场领先地位。

此系统搭载DST(德仕特)动力冲击技术，最大程度优化了阀的效率，实现最完美的点胶结果。

MDS 1560热熔胶系列适合所有型号的热熔胶及石蜡粘合剂，是超微胶点/线的最优点胶方案。

VERMES Microdispensing微密斯点胶科技最新MDS 1560热熔胶系统最高可加热至230摄氏度，专为超高温应用设计，满足工业生产制造的

特殊要求。

将久经测试的DST动力冲击技术融合到热熔胶系统，不仅拓宽了我们的产品线，也迎合当前市场需求。对客户需求的预判能力让我们走在热熔胶点胶市场的前沿，推出定位精准的产品。” VERMES Microdispensing微密斯点胶科技的CEO兼总经理Juergen Staedtler（于尔根·施泰特勒）说道。

极速加热、超高温、稳定恒温，这些性能为持续性、高频率、可重复的精准点胶提供了最理想的保障。



- DST(德仕特)动力冲击技术
- 适合各种热熔胶应用的完美解决方案
- 专为热熔胶点胶设计
- 电子制造的理想选择
- 灵活自定义参数设置
- 可实现复杂点胶样式
- 超长的介质使用寿命

新款MDS 1560热熔胶系统操作简便，无需初始校准或额外冷却装置。

此系统允许在多个点胶节点更改点胶参数，例如停机、启动甚至任一斜率点（无论哪种点胶条件），撞针撞击介质的速度、压力都可完美保持一致。

胶筒温度和喷嘴温度均可任意调整，使介质达到最完美的粘度状态。

对于生产线，正常运行时间与成本控制至关重要。此系统搭配精简模块化无线液盒，便于更换。系统拆装无工具化，便捷省时。此外，胶筒在加热后也可快速更换，有效降低用户成本，简化操作，提升产能，稳固保障。

MDS 1560热熔胶点胶系统是各类工业应用的理想方案，包括电子制造业，例如焊合电子配件、智能手机组件及3D-MID（三维模塑互连器件）。对于点胶的精准控量和精确定位使该系统同样适合非连续性的粘合剂涂覆应用。

MDS 1560热熔胶系列与VERMES Microdispensing微密斯点胶科技所有现存配件均可完美兼容，包括上百种撞针和喷嘴，最大程度满足配置灵活性。

## VERMES Microdispensing GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2  
83607 Holzkirchen | Germany

+49 (0) 8024 6 44 0 | +49 (0) 8024 6 44 19



[sales@vermes.com](mailto:sales@vermes.com) | [www.vermes.com](http://www.vermes.com)

Germany  
+49 (0)8024 644 - 0  
[info@vermes.com](mailto:info@vermes.com)

China  
+86 (0)592 7257233  
[info@vermes.com](mailto:info@vermes.com)

USA  
+1 408 520-2555  
[america@vermes.com](mailto:america@vermes.com)

Korea  
+82 (0)32-246-1500  
[korea@vermes.com](mailto:korea@vermes.com)

Malaysia  
+60 4 358 0996  
[info@vermes.com](mailto:info@vermes.com)

